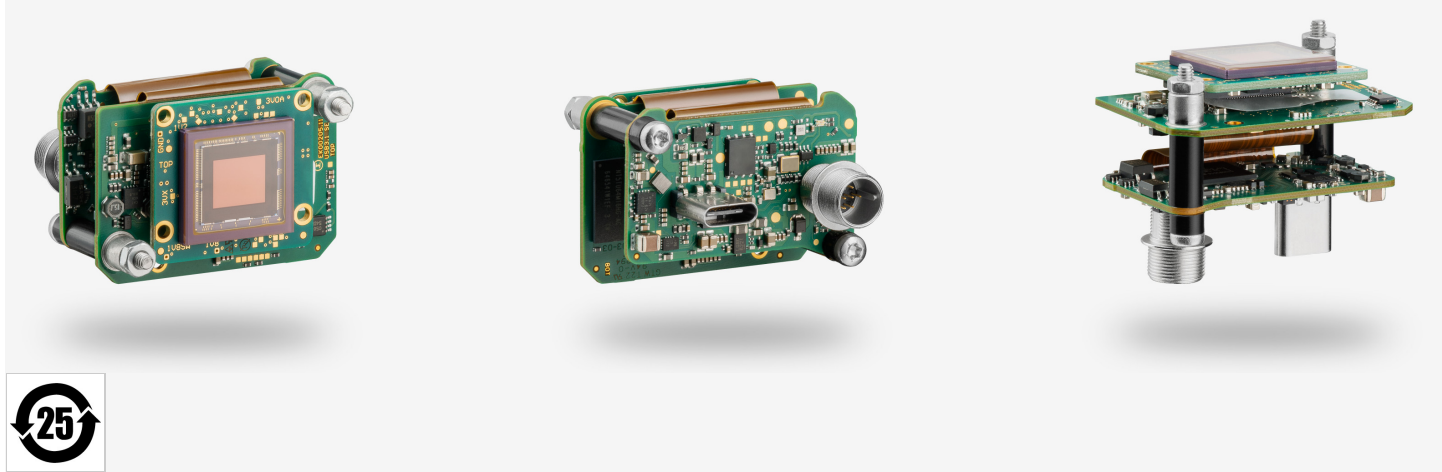
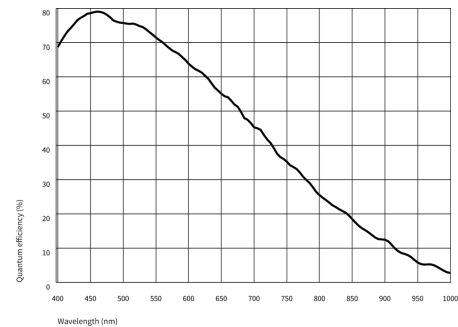


■ 系列
此型號是屬於長久生命週期的產品系列。



规格

传感器	
传感器技术	CMOS 黑白
快门	全局快门
特征	线性
像素级别	5 MP
分辨率	5.10 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	2472 x 2064 像素
长宽比	5:4
模数转换器	12 bit
色深 (相机)	12 bit
光学传感器等级	1/1.8"
光学尺寸	6.773 mm x 5.655 mm
光学传感器对角线	8.82 mm 1/1.8"
像素尺寸	2.74 µm
CRA (雷·安格尔局长)	0 °
生产商	Sony
传感器型号	IMX547-AAMJ-C
增益 (主色/RGB)	16x/-
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度, 步长	256 / 2
AOI图像高度, 步长	1 / 1
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	2 / 1
水平方向上的像素融合	增加的帧率
垂直方向上的像素融合	增加的帧率
像素融合方法	水平: 附加 / 垂直: 附加
像素融合因子	2x2
水平方向上的 decimation (子抽点)	增加的帧率
垂直方向上的 decimation (子抽点)	增加的帧率
Decimation (子抽点)方法	M/C自动



可能随技术进步有所更改 (2026-09-13)

U3-31F2SE-M Rev.1.2 (1009203)

型号

自由运行模式下帧率	75 fps
帧率触发(持续的)	75 fps
帧率触发(最大值)	75 fps
曝光时间 (最小值 - 最大值)	0.0085 ms - 2000 ms
长时间曝光 (最长)	120000 ms
线速自由运行模式 (线阵扫描)	1118 1/s
线速触发模式 (线阵扫描)	1126 1/s
每帧行数 (线阵扫描)	8000
功耗	1.9 W - 3.9 W
图像内存	128 MB

HDR

模式	Sequencer
----	-----------

工作环境要求

对于PCB版本，请参考各自文档中的单独提示。

运行期间允许的装置温度范围	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
存储期间允许的装置温度范围	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度 (相对湿度，无凝结)	20 % - 80 %

连接器

接口连接器	USB Type-C
I/O连接器	Hirose 8-pin连接器 (HR25-7TR-8PA (73))
电源	USB线缆

引脚分配 I/O 连接器

1	接地 (GND)
2	带光耦闪光输出 (-) - Line 1
3	GPIO接口 1, 3.3 V - Line 2
4	带光耦触发输入 (-) - Line 0
5	带光耦闪光输出 (+) - Line 1
6	GPIO接口 2, 3.3 V - Line 3
7	带光耦触发输入 (+) - Line 0
8	输出电源电压, 5V (100mA)



外观设计

镜头接口	No mount
防护等级	-
尺寸 高/宽/长	29.5 mm x 40.0 mm x 25.0 mm
总重量	20 g
外壳材料	-

Features

相机图像预处理功能列表。

工作台的所有功能均可通过我们的 ids peak 软件在主机上进行图像预处理 (取决于传感器型号)。

可能随技术进步有所更改 (2026-09-13)

第2页，共3页

www.ids-imaging.com

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · 电子邮箱 apacsales@ids-imaging.com



U3-31F2SE-M Rev.1.2 (1009203)

图像采集	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	✓
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	✓
闪烁	Flashing	✓
	PWM flashing	✓
图像调整]	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	X/Y
车载图像处理	Pixel formats	Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	2x2
	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
其他	Chunks	✓
	Sequencer	✓
	Events	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.6

可能随技术进步有所更改 (2026-09-13)